

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2007-200842

(P2007-200842A)

(43) 公開日 平成19年8月9日(2007.8.9)

(51) Int. Cl.	F I	テーマコード (参考)
H05B 33/04 (2006.01)	H05B 33/04	3K107
H05B 33/10 (2006.01)	H05B 33/10	5C094
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14 A	
G09F 9/30 (2006.01)	G09F 9/30 309	
H01L 27/32 (2006.01)	G09F 9/30 365Z	
審査請求 有 請求項の数 23 O L (全 15 頁)		

(21) 出願番号 特願2006-178508 (P2006-178508)
 (22) 出願日 平成18年6月28日 (2006.6.28)
 (31) 優先権主張番号 10-2006-0007353
 (32) 優先日 平成18年1月24日 (2006.1.24)
 (33) 優先権主張国 韓国 (KR)
 (31) 優先権主張番号 10-2006-0025755
 (32) 優先日 平成18年3月21日 (2006.3.21)
 (33) 優先権主張国 韓国 (KR)

(71) 出願人 590002817
 三星エスディアイ株式会社
 大韓民国京畿道水原市靈通区▲しん▼洞5
 75番地
 (74) 代理人 100089037
 弁理士 渡邊 隆
 (74) 代理人 100064908
 弁理士 志賀 正武
 (74) 代理人 100108453
 弁理士 村山 靖彦
 (72) 発明者 李 鍾禹
 大韓民国京畿道龍仁市器興邑貢稅里428
 -5 三星エスディアイ中央研究所内

最終頁に続く

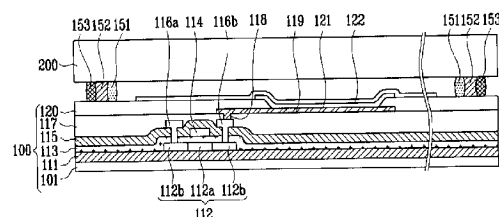
(54) 【発明の名称】 有機電界発光表示装置及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 封止材の他に接着剤及び補強材をさらに備えて耐衝撃性の強い有機電界発光表示装置及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 第1電極、有機層及び第2電極から構成される少なくとも1つの有機発光素子が形成された画素領域と前記画素領域の外縁に形成される非画素領域を含む第1基板と、前記第1基板の前記画素領域を含む一領域に貼り合わされる第2基板と、前記第1基板の前記非画素領域と前記第2基板との間に備えられ、前記第1基板と前記第2基板を接着するフリットと、前記フリットの外郭に沿って離隔されて塗布され、少なくとも2つ以上の不連続部を備える接着剤と、前記フリットと前記接着剤との間に備えられる補強材とを含む。

【選択図】 図3



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 電極、有機層、及び第 2 電極から構成される少なくとも 1 つの有機発光素子が形成された画素領域と、前記画素領域の外縁に形成される非画素領域とを含む第 1 基板と、

前記第 1 基板の前記画素領域を含む一領域に貼り合わされる第 2 基板と、

前記第 1 基板の前記非画素領域と前記第 2 基板との間に備えられ、前記第 1 基板と前記第 2 基板を接着するフリットと、

前記フリットの外郭に沿って離隔されて塗布され、少なくとも 2 つ以上の不連続部を備える接着剤と、

前記フリットと前記接着剤との間に備えられる補強材と、を含むことを特徴とする有機電界発光表示装置。 10

【請求項 2】

前記フリットは、レーザまたは赤外線を吸収する吸収材をさらに含むことを特徴とする請求項 1 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 3】

前記補強材は、前記接着剤よりも粘度の低い物質から構成されることを特徴とする請求項 1 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 4】

前記補強材の粘度は、100cp～4000cpであることを特徴とする請求項 3 に記載の有機電界発光表示装置。 20

【請求項 5】

前記補強材は、エポキシ、アクリル、及びウレタン系で構成される群から選択された少なくとも 1 つの材料で構成されることを特徴とする請求項 3 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 6】

前記接着剤は、エポキシ、アクリレート、ウレタンアクリレート、シアノアクリレートで構成される群から選択された少なくとも 1 つの樹脂系であることを特徴とする請求項 1 に記載の有機電界発光表示装置。

【請求項 7】

少なくとも 1 つの有機発光素子が形成された画素領域及び前記画素領域の外縁に形成される非画素領域を含む第 1 基板と、前記第 1 基板の前記画素領域を含む一領域に貼り合わされる第 2 基板を含んで構成される有機電界発光表示装置の製造方法において、 30

前記第 2 基板の一領域上にフリットを塗布した後に焼成する段階と、

前記フリットの外郭に沿って接着剤を塗布する段階と、

前記第 1 基板と前記第 2 基板を貼り合わせる段階と、

前記接着剤を硬化する段階と、

前記フリットにレーザまたは赤外線を照射する段階と、

前記接着剤の一領域を貫通して少なくとも 2 つ以上の不連続部を形成する段階と、

前記不連続部を介して前記フリットと前記接着剤との間に補強材を注入する段階と、を含むことを特徴とする有機電界発光表示装置の製造方法。 40

【請求項 8】

前記補強材を注入する段階は、毛細管現象を利用するか、圧力差を利用して行うことを特徴とする請求項 7 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 9】

前記補強材を注入した後に硬化する段階をさらに含むことを特徴とする請求項 7 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 10】

前記補強材を硬化する段階は、紫外線または熱または急速硬化を用いて行うことを特徴とする請求項 9 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 11】

前記接着剤を塗布する段階は、スクリーンプリントまたはディスペンス法を用いて行うことを特徴とする請求項 7 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 12】

前記接着剤を硬化する段階は、紫外線または熱工程を用いて行うことを特徴とする請求項 7 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 13】

前記フリットに照射されるレーザーの強度は、25W～60Wの範囲であることを特徴とする請求項 7 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 14】

前記フリットを焼成する温度は、300～700の範囲であることを特徴とする請求項 7 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。 10

【請求項 15】

有機発光素子が形成された少なくとも 1 つの画素領域及び前記画素領域の周辺に形成された非画素領域を含む第 1 マザー基板と、前記第 1 マザー基板と貼り合わされる第 2 マザー基板を含む有機電界発光表示装置の製造方法において、

前記第 2 マザー基板の前記画素領域の外郭にフリットを塗布した後に焼成する段階と、

前記フリットの外郭に沿って離隔されるように接着剤を塗布する段階と、

前記第 1 マザー基板と前記第 2 マザー基板を貼り合わせる段階と、

前記接着剤を硬化する段階と、

前記フリットにレーザーまたは赤外線を照射する段階と、 20

貼り合わされた前記第 1 マザー基板と前記第 2 マザー基板を複数の表示パネルに切断する段階と、

前記フリットと前記接着剤との間に補強材を注入する段階と、

前記補強材を硬化する段階と、を含むことを特徴とする有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 16】

前記接着剤は、少なくとも 1 つの不連続部を備えて塗布されることを特徴とする請求項 15 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 17】

前記補強材を注入する段階は、毛細管現象を利用して行うことを特徴とする請求項 15 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。 30

【請求項 18】

前記補強材を注入する段階は、圧力差を利用して行うことを特徴とする請求項 15 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 19】

前記補強材を硬化する段階は、紫外線を用いて行うことを特徴とする請求項 15 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 20】

前記補強材を硬化する段階は、熱硬化を用いて行うことを特徴とする請求項 15 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。 40

【請求項 21】

前記補強材を硬化する段階は、急速硬化を用いて行うことを特徴とする請求項 15 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 22】

前記接着剤を塗布する段階は、スクリーンプリントまたはディスペンス法を用いて行うことを特徴とする請求項 15 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

【請求項 23】

前記接着剤を硬化する段階は、紫外線または熱工程を用いて行うことを特徴とする請求項 15 に記載の有機電界発光表示装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、有機電界発光表示装置及びその製造方法に関し、より詳細には、封止材の他に補強材をさらに備えて素子の耐衝撃性及び封止特性を向上させる有機電界発光表示装置及びその製造方法に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、有機発光ダイオード (Organic Light Emitting Diode) を用いた有機電界発光表示装置 (Organic Light Emitting Display Device) が注目されている。

10

【0003】

有機電界発光表示装置とは、蛍光性を有する有機化合物を電氣的に励起させて発光する自発光型ディスプレイのことをいい、低い電圧で駆動が可能で、かつ、薄型化が容易であり、また、広視野角や、速い応答速度といった長所を持つ。

【0004】

有機電界発光表示装置は、基板上に有機発光素子と、有機発光素子を駆動するための TFT (Thin Film Transistor) を含む複数の画素を備える。このような有機発光素子は、酸素及び水分に敏感であり、吸収剤が塗布された金属キャップや封止ガラス基板で蒸着基板にカバーをし、酸素及び水分の侵入を防止する封止構造が提案されている。

20

【0005】

また、ガラス基板にフリット (frit) を塗布して有機発光ダイオードを封止する構造は特許文献 1 に開示されている。特許文献 1 に開示された発明によれば、フリットを用いることで、基板と封止基板との間が完全に封止され、さらに効率よく有機発光素子を保護することができる。

【0006】

しかしながら、一般にフリットを塗布した封止基板を用いて有機発光素子を封止する構造においては、フリットにレーザを照射する工程時にレーザの熱のため、基板に応力が生じてしまう。これにより、マザー基板を単位基板に切断 (scribing) する工程を行う際に、切断ラインがきれいに形成されず、クラックに繋がる恐れもある。そのため、不良素子の発生率が増加し、さらに、素子の信頼性をテストする際に耐衝撃性が弱くなるという問題点があった。

30

【特許文献 1】米国特許出願公開 2004/0207314 号明細書

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

したがって、本発明は、上記した従来技術の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、封止材の他に接着剤及び補強材をさらに備えて耐衝撃性の強い有機電界発光表示装置及びその製造方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

40

【0008】

上記目的を達成するために、本発明に係る有機電界発光表示装置は、第 1 電極、有機層及び第 2 電極から構成される少なくとも 1 つの有機発光素子が形成された画素領域と前記画素領域の外縁に形成される非画素領域を含む第 1 基板と、前記第 1 基板の前記画素領域を含む一領域に貼り合わされる第 2 基板と、前記第 1 基板の前記非画素領域と前記第 2 基板との間に備えられ、前記第 1 基板と前記第 2 基板を接着するフリットと、前記フリットの外郭に沿って離隔されて塗布され、少なくとも 2 つ以上の不連続部を備える接着剤と、前記フリットと前記接着剤との間に備えられる補強材とを含むことを特徴とする。

【0009】

また、本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法は、少なくとも 1 つの有機発光素

50

子が形成された画素領域及び前記画素領域の外縁に形成される非画素領域を含む第1基板と、前記第1基板の前記画素領域を含む一領域に貼り合わされる第2基板を含んで構成される有機電界発光表示装置の製造方法において、前記第2基板の一領域上にフリットを塗布した後に焼成する段階と、前記フリットの外郭に沿って接着剤を塗布する段階と、前記第1基板と前記第2基板を貼り合わせる段階と、前記接着剤を硬化する段階と、前記フリットにレーザまたは赤外線を照射する段階と、前記接着剤の一領域を貫通して少なくとも2つ以上の不連続部を形成する段階と、前記不連続部を介して前記フリットと前記接着剤との間に補強材を注入する段階とを含むことを特徴とする。

【0010】

さらに、本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法は、有機発光素子が形成された少なくとも1つの画素領域及び前記画素領域の周辺に形成された非画素領域を含む第1マザー基板と、前記第1マザー基板と貼り合わされる第2マザー基板を含む有機電界発光表示装置の製造方法において、前記第2マザー基板の前記画素領域の外郭にフリットを塗布した後に焼成する段階と、前記フリットの外郭に沿って離隔されるように接着剤を塗布する段階と、前記第1マザー基板と前記第2マザー基板を貼り合わせる段階と、前記接着剤を硬化する段階と、前記フリットにレーザまたは赤外線を照射する段階と、貼り合わされた前記第1マザー基板と前記第2マザー基板を複数の表示パネルに切断する段階と、前記フリットと前記接着剤との間に補強材を注入する段階と、前記補強材を硬化する段階とを含むことを特徴とする。

【発明の効果】

【0011】

本発明に係る有機電界発光表示装置及びその製造方法によれば、フリットの他に補強材と接着剤をさらに備えて素子の耐衝撃性と耐応力を強化させることができるという効果を奏する。これにより、マザー基板を複数の単位基板に切断する工程を行う際に素子不良が発生する頻度を低下させることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0012】

以下、本発明の好適な実施の形態について、図面を参照しながら詳細に説明する。

【0013】

図1は、本発明に係る有機電界発光表示装置の一例を示す平面概念図、図2は、本発明に係る有機電界発光表示装置に採用された封止基板の一例を示す平面図である。

【0014】

図1及び図2を参照して説明すれば、本発明に係る有機電界発光表示装置は、第1基板100、フリット151、接着剤152、補強材153及び第2基板200を含む。

【0015】

第1基板100は、画素領域100a及び非画素領域100bを含む。画素領域100aは複数の走査線S1、S2、...、Sn及び複数のデータ線D1、D2、...、Dmを備え、走査線S1、S2、...、Sn及びデータ線D1、D2、...、Dmにより画定された領域に複数の画素50を備える。この時、各画素50は特定の走査線S1、S2、...、Snとデータ線D1、D2、...、Dm及び電源線（図示せず）に接続され、赤、緑、青及び白の何れかの色を所定の輝度レベルに表示する。したがって、画素領域100aは、各画素50の色と輝度に応じて所定の画像を表示する。非画素領域100bは、画素領域100aの外縁に形成され、第1基板100上の画素領域100aではない全ての領域を示す。一方、非画素領域100bはデータ駆動部300、走査駆動部400及びパッド部500を含む。

【0016】

データ駆動部300は、第1基板100の画素領域100a内に延びている複数のデータ線D1、D2、...、Dmにデータ信号を供給する。データ駆動部300は第1基板100で画素領域100aの一側面に形成され、走査駆動部400が形成される画素領域100aの一側面に隣接する他の一側面に形成される。この時、データ駆動部300はCO

G (Chip On Glass) 方式でチップ状に第 1 基板 100 上に実装される。また、データ駆動部 300 は複数のデータ供給線 310 によりパッド部 500 内の複数の第 1 パッド Pd に接続される。

【0017】

走査駆動部 400 は画素領域 100 a 内に延びている複数の走査線 S1、S2、...、Sn に順次走査信号を供給する。走査駆動部 400 は第 1 基板 100 で画素領域 100 a の一側面に形成され、少なくとも 1 つの走査供給線 410 によりパッド部 500 内の少なくとも 1 つの第 1 パッド Ps に接続される。

【0018】

パッド部 500 は第 1 基板 100 に走査駆動部 400 及びデータ駆動部 300 と隣接して形成され、走査供給線 410 及びデータ供給線 310 に電氣的に接続されて画素領域 100 a の複数の走査線 S1、S2、...、Sn 及び複数のデータ線 D1、D2、...、Dm のそれぞれに電氣的信号を供給する。 10

【0019】

フリット 151 は第 1 基板 100 の非画素領域 100 b と第 2 基板 200 との間に備えられ、第 1 基板 100 と第 2 基板 200 を接着させる。図中では、内蔵型走査駆動部 400 を備え、画素領域 100 a と走査駆動部 400 が封止されるようにフリット 151 が塗布される例を示したが、走査駆動部 400 が外装型である場合に画素領域 100 a のみ含まれるように塗布され得る。すなわち、フリット 151 により第 1 基板 100 と第 2 基板 200 との間が封止されるので、第 1 基板 100 と第 2 基板 200 との間に介在された有機発光素子が水分または酸素から保護されることができる。この時、フリット 151 は熱膨張係数を調節するためのフィラー（図示せず）及びレーザまたは赤外線を吸収する吸収材（図示せず）を含む。また、フリット 151 はレーザまたは赤外線照射により硬化される。この時、フリット 151 に照射されるレーザの強度は 25 W ~ 60 W の範囲にする。 20

【0020】

一方、ガラス材料に加えられる熱の温度を急激に低下させるとガラス粉末状のフリットが生成される。一般には、ガラス粉末に酸化物粉末を含んで使用する。そして、フリットに有機物を添加すれば、ゲル状のペーストになる。この時、所定の温度で焼成すれば、有機物は空气中に消滅し、ゲル状のペーストは硬化されて固体状のフリットとして存在する。この時、フリット 151 を焼成する温度は、300 ~ 700 の範囲にする。 30

【0021】

接着剤 152 は、フリット 151 の外郭に沿って離隔されて塗布され、少なくとも 2 つ以上の不連続部 52 を備える。すなわち、補強材 153 が注入される入口としての機能をする少なくとも 1 つの不連続部 52 の以外に少なくとも 1 つの不連続部 52 をさらに備えて、補強材 153 が注入される空間に存在する気泡が外部に抜け出せるようにする。すなわち、少なくとも 2 つの不連続部 52 を備えなければならない補強材 153 が、フリット 151 と接着剤 152 との間の空間に均等に塗布されることができる。この時、接着剤 152 はフリット 151 にレーザを照射した後、マザー基板（図示せず）を単位基板（図示せず）に切断する工程においてフリット 151 に加えられる衝撃を分散させる役割を果たす。一方、接着剤 152 は、エポキシ、アクリレート、ウレタンアクリレート、シアノアクリレートで構成される群から選択された少なくとも 1 つの樹脂系の材料で形成されることが好ましい。また、接着剤 152 は封止ライン（図示せず）に沿って連続的に塗布されるが、接着剤 152 が連続せず途絶える少なくとも 2 つの不連続部 52 を備える。一方、接着剤 152 は紫外線または熱工程により硬化される。 40

【0022】

補強材 153 は、フリット 151 と接着剤 152 との間に備えられ、接着剤 152 の不連続部 52 を介してフリット 151 と接着剤 152 との間に注入される。この時、補強材 153 はフリット 151 により接着されている第 1 基板 100 と第 2 基板 200 がフリット 151 に照射されるレーザの熱により基板の切断工程時に損傷し易くなることを防止するために備えられる。一方、補強材 153 は接着剤 152 よりも粘度の低い物質を使用し 50

なければならず、エポキシ、アクリル及びウレタン系で構成される群から選択された少なくとも1つの材料で形成されることが好ましい。この時、補強材153が接着剤152よりも粘度が高いか、または同一である場合は補強材153が流動し難くなるため、不連続部52を介して補強材153を均等に注入するのに困難が生じる。これに適した補強材153の好ましい粘度は、100cp~4000cpの範囲である。

【0023】

第2基板200は、第1基板100の画素領域100aを含む一領域に貼り合わされる。この時、第2基板200は第1基板100の画素領域100a上に形成された有機発光素子(図示せず)が外部からの水分または酸素の影響を受けないように保護するために備えられたものである。この時、第2基板200に制限はないが、酸化シリコン(SiO_2)、シリコンナイトライド(SiNx)、シリコンオキシナイトライド(SiO_xN_y)で構成される群から選択された少なくとも1つの材料で形成することが可能である。

10

【0024】

図2は、本発明に係る有機電界発光表示装置の一例を示す断面図である。

【0025】

図2を参照して説明すれば、本発明に係る有機電界発光表示装置は、第1基板100、フリット151、接着剤152、補強材153及び第2基板200を含む。

【0026】

第1基板100は、蒸着基板101及び蒸着基板101上に形成される少なくとも1つの有機発光素子110を含む。まず、蒸着基板101上にバッファ層111が形成される。蒸着基板101はガラスなどで形成され、バッファ層111は酸化シリコン(SiO_2)または窒化シリコン(SiNx)などのような絶縁物質で形成される。一方、バッファ層111は外部からの熱などの要因により蒸着基板101が損傷するのを防止するために形成される。

20

【0027】

バッファ層111の少なくとも何れかの一領域上には、アクティブ層112aとソース及びドレイン領域112bを備える半導体層112が形成される。

【0028】

半導体層112を含めてバッファ層111上にはゲート絶縁層113が形成され、ゲート絶縁層113の一領域上にはアクティブ層112aの幅に対応する大きさのゲート電極114が形成される。

30

【0029】

ゲート電極114を含めてゲート絶縁層113上には層間絶縁層115が形成され、層間絶縁層115の所定の領域上にはソース及びドレイン電極116a、116bが形成される。

【0030】

ソース及びドレイン電極116a、116bは、ソース及びドレイン領域112bの露出された一領域とそれぞれ接続されるように形成され、ソース及びドレイン電極116a、116bを含めて層間絶縁層115上には平坦化層117が形成される。

【0031】

平坦化層117の一領域上には第1電極119が形成され、この時、第1電極119はビアホール118によりソース及びドレイン電極116a、116bの何れかの露出された一領域と接続される。

40

【0032】

第1電極119を含めて平坦化層117上には第1電極119の少なくとも一領域を露出する開口部(図示せず)が備えられた画素画定膜120が形成される。

【0033】

画素画定膜120の開口部上には有機層121が形成され、有機層121を含めて画素画定膜120上には第2電極層122が形成される。

【0034】

50

フリット 151 は第 1 基板 100 の非画素領域 100b と第 2 基板 200 との間に備えられ、第 1 基板 100 と第 2 基板 200 を接着させる。フリット 151 は、第 1 基板 100 に形成された画素領域 100a と走査駆動部 400 が封止されるように塗布されることが好ましく、画素領域 100a のみ含まれるように塗布されることができる。また、図中では、フリット 151 が画素画定膜 120 上に形成される例を示しているが、これに限定されない。

【0035】

接着剤 152 はフリット 151 の外郭に沿って離隔されて塗布され、少なくとも一領域に不連続部 52 を備える。この時、接着剤 152 はフリット 151 にレーザを照射した後、マザー基板（図示せず）を単位基板（図示せず）に切断する工程においてフリット 151 に加えられる衝撃を分散させる役割を果たす。また、接着剤 152 は封止ライン（図示せず）に沿って連続的に塗布されるが、少なくとも 2 つの領域に接着剤 152 が連続せず途絶える不連続部 52 を備える。

10

【0036】

補強材 153 はフリット 151 と接着剤 152 との間に備えられ、接着剤 152 の不連続部 52 を介してフリット 151 と接着剤 152 との間に注入される。この時、補強材 153 はフリット 151 により接着されている第 1 基板 100 と第 2 基板 200 がフリット 151 に照射されるレーザの熱により基板の切断工程時に損傷し易くなることを防止するために備えられる。

【0037】

フリット 151、接着剤 152 及び補強材 153 に対するより詳細な説明は、図 2 を参照して説明したのと同様であるため、繰り返しは省略する。

20

【0038】

第 2 基板 200 は、第 1 基板 100 上に形成された前記所定の構造物を外部の酸素及び水分から保護するために所定の構造物を挟んで、フリット 151 により第 1 基板 100 と貼り合わされる。この時、第 2 基板 200 は酸化シリコン（ SiO_2 ）、シリコンナイトライド（ SiN_x ）、シリコンオキシナイトライド（ SiO_xN_y ）で構成される群から選択された少なくとも 1 つの材料で形成されることが好ましい。

【0039】

図 4 は、本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法の第 1 の実施形態を示す順序図である。

30

【0040】

図 4 を参照して説明すれば、本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法は、第 1 段階（ST100）乃至第 7 段階（ST700）にかけて行われる。

【0041】

第 1 段階（ST100）は、第 2 基板の一領域上にフリットを塗布した後に焼成するステップである。すなわち、第 2 基板と非画素領域との間にフリットが介在されるようにする。この時、フリットは第 1 基板に形成された画素領域と走査駆動部が封止されるように塗布することが好ましく、画素領域のみ含まれるように塗布することもできる。この時、フリットは熱膨張係数を調節するためのフィラー及びレーザまたは赤外線を吸収する吸収材を含む。

40

【0042】

一方、ガラス材料に加えられる熱の温度を急激に低下させるとガラス粉末状のフリットが生成される。一般には、フリットに酸化物粉末を含んで使用する。そして、酸化物粉末が含まれているフリットに有機物を添加すれば、ゲル状のペーストになる。このゲル状のペーストを第 2 基板の封止ラインに沿って塗布する。この後、フリットに所定の温度で熱処理を行えば、有機物は空気中に消滅し、ゲル状のペーストは硬化されて固体状のフリットとして存在する。この時、フリットを焼成する温度は、300 ～ 700 の範囲にすることが好ましい。

【0043】

50

第2段階（ST200）は、フリットの外郭に沿って連続的に接着剤を塗布するステップである。この時、前記接着剤は、エポキシ、アクリレート、ウレタンアクリレート、シアノアクリレートで構成される群から選択された少なくとも1つの樹脂系の材料で形成されることが好ましい。また、接着剤を塗布する工程はスクリーンプリントまたはディスペンス法を用いて行える。スクリーンプリントとは、網構造を有する金属材シートに所望の図柄を入れた後、図柄を除いた部分にはエマルジョン液を利用してマスキングし、補強材をスクイーズで押して第2基板上に所望の図柄に印刷する方法をいう。そして、ディスペンスとは第2基板にノズルを持つ装置であり、補強材を一定の形態と量を有するように描く方法をいう。

【0044】

第3段階（ST300）は第1基板と前記第2基板を貼り合わせるステップである。この時、第1基板には、第1電極、有機層、第2電極を含む少なくとも1つの有機発光素子が形成されており、有機発光素子が第1基板と第2基板との間に位置するように配列してから第1基板と第2基板を貼り合わせる。

【0045】

第4段階（ST400）は接着剤を硬化するステップである。この時、紫外線または熱処理工程を通じて接着剤を硬化させる。

【0046】

第5段階（ST500）はフリットを溶融させるステップである。この時、フリットはレーザまたは赤外線を吸収する機能をし、レーザまたは赤外線照射により溶融される。ここで、フリットを溶融させるための好ましいレーザ強度の範囲は、25W～60Wである。フリットが溶融されることにより、第1基板と第2基板が接着される。

【0047】

第6段階（ST600）は接着剤の少なくとも2つの領域を貫通して不連続部を形成するステップである。すなわち、接着剤とフリットを硬化させた後、接着剤の少なくとも2つの領域を貫通する。これにより、フリットに沿って連続的に塗布されていた接着剤は少なくとも2つの領域が途絶えた形態として存在する。これは、補強材が注入される入口としての役割をする少なくとも1つの不連続部の他に少なくとも1つの不連続部をさらに備えて補強材が注入される空間の気泡が抜け出せるようにするためである。すなわち、少なくとも2つの不連続部を備えなければならない後続する工程において補強材がフリットと接着剤との間の空間に均等に塗布されることができる。

【0048】

第7段階（ST700）は不連続部を介してフリットと接着剤との間に補強材を注入するステップである。フリットと接着剤は所定の間隔だけ離隔されて形成されるため、フリットと接着剤の間には空き空間が形成される。この空き空間により、第1基板と第2基板は完全に貼り合わされず、これにより衝撃に弱くなる恐れがある。すなわち、マザー基板を単位基板に切断する工程を行う際にクラックが生じるなどの損傷が起こり易くなる。したがって、補強材はフリットと接着剤との間に存在する空き空間が埋められるように形成して、所定の工程が行われる時に加えられる衝撃を吸収するようにする。一方、補強材は接着剤よりも粘度の低い物質を使用しなければならず、エポキシ、アクリル及びウレタン系で構成される群から選択された少なくとも1つの材料で形成されることが好ましい。この時、補強材が接着剤よりも粘度が高いか、または同一である場合は補強材が流動し難くなるため、不連続部を介して補強材を注入するのに困難が生じる。これに適した補強材の好ましい粘度は、100cp～4000cpの範囲である。また、補強材を注入する工程は、毛細管現象を利用するか、圧力差を利用して行い、この後、補強材を硬化する。この時、補強材を硬化する工程は、紫外線または熱または急速硬化（rapid curing）を用いて行える。

【0049】

図5a乃至図5fは、本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法の第2の実施形態を示す斜視図である。

10

20

30

40

50

【 0 0 5 0 】

図 5 a 乃至図 5 f を参照して説明すれば、本発明に係る有機電界発光表示装置は、有機発光素子が形成された少なくとも 1 つの画素領域 1 0 0 a 及び前記画素領域 1 0 0 a の周辺に形成された非画素領域 1 0 0 b を含む第 1 マザー基板 1 0 0 0 と、前記第 1 マザー基板 1 0 0 0 と貼り合わされる第 2 マザー基板 2 0 0 0 を含む。

【 0 0 5 1 】

前述した構成要素を利用した有機電界発光表示装置の製造方法は、まず、第 2 マザー基板 2 0 0 0 の非画素領域 1 0 0 b と対応する領域にフリット 1 5 1 を塗布した後に焼成する。すなわち、第 2 マザー基板 2 0 0 0 と非画素領域 1 0 0 b との間にフリット 1 5 1 が介在されるようにする。この時、フリット 1 5 1 は熱膨張係数を調節するためのフィラー（図示せず）及びレーザまたは赤外線を吸収する吸収材（図示せず）を含む。

10

【 0 0 5 2 】

一方、ガラス材料に加えられる熱の温度を急激に低下させるとガラス粉末状のフリット 1 5 1 が生成される。一般には、フリット 1 5 1 に酸化物粉末を含んで使用する。そして、酸化物粉末が含まれているフリット 1 5 1 に有機物を添加すれば、ゲル状のペーストになる。このゲル状のペーストを第 1 注入部 1 6 0 a を利用して第 2 マザー基板 2 0 0 0 の封止ラインに沿って塗布する。その後、フリット 1 5 1 に所定の温度で熱処理を行えば、有機物は空気中に消滅し、ゲル状のペーストは硬化されて固体状のフリットとして存在する。この時、フリット 1 5 1 を焼成する温度は、3 0 0 ~ 7 0 0 の範囲にすることが好ましい。（図 5 a ）

20

【 0 0 5 3 】

その後、フリット 1 5 1 の外郭に沿って離隔されるように第 2 注入部 1 6 0 b を利用して接着剤 1 5 2 を塗布する。この時、接着剤 1 5 2 は少なくとも 1 つの不連続部 5 2 を備えるように形成する。ここで、不連続部 5 2 とは、接着剤 1 5 2 が連続的に形成されておらず、所定の間隔にその連結が途絶えている領域のことをいう。好ましくは、補強材 1 5 3 が注入される入口としての役割をする少なくとも 1 つの不連続部 5 2 の他に少なくとも 1 つの不連続部 5 2 をさらに備えて、補強材 1 5 3 が注入される空間の気泡が抜け出せるようにする。すなわち、少なくとも 2 つの不連続部 5 2 を備えなければならない後続する工程で補強材 1 5 3 がフリット 1 5 1 と接着剤との間の空間に均等に塗布されることができる。この時、接着剤 1 5 2 は、エポキシ、アクリレイト、ウレタンアクリレイト、シアノアクリレートで構成される群から選択された少なくとも 1 つの樹脂系の材料で形成されることが好ましい。

30

【 0 0 5 4 】

さらに、接着剤 1 5 2 を塗布する工程は、スクリーンプリントまたはディスペンス法を用いて行える。スクリーンプリントは、網構造の金属材シートに所望の図柄を入れた後に図柄を除いた部分にはエマルジョン液を用いてマスキングし、補強材をスクイーズで押しつけて基板上に所望の図柄に印刷する方法である。そして、ディスペンスは基板にノズルを持つ装置であり、補強材を一定の形態と量を有するように描く方法である。（図 5 b ）

【 0 0 5 5 】

その後、第 1 マザー基板 1 0 0 0 と第 2 マザー基板 2 0 0 0 を貼り合わせる。この時、第 1 マザー基板 1 0 0 0 には第 1 電極、有機層、第 2 電極を含む少なくとも 1 つの有機発光素子（図示せず）が形成されており、有機発光素子が第 1 マザー基板 1 0 0 0 と第 2 マザー基板 2 0 0 0 との間に位置するように配列した後、第 1 マザー基板 1 0 0 0 と第 2 マザー基板 2 0 0 0 を貼り合わせる。（図 5 c ）

40

【 0 0 5 6 】

この後、接着剤 1 5 2 を硬化する。この時、接着剤 1 5 2 は、紫外線または熱処理工程を用いて硬化させることができる。

【 0 0 5 7 】

後続する工程により、フリット 1 5 1 にレーザまたは赤外線を照射してフリット 1 5 1 を溶融させた後に硬化されるようにする。この時、フリット 1 5 1 は熱膨張係数を調節す

50

るためのフィラー（図示せず）及びレーザまたは赤外線を吸収する吸収材（図示せず）をその内部に含む。ここで、フリット１５１を溶融させるための好ましいレーザの強度の範囲は、２５Ｗ～６０Ｗである。フリット１５１が溶融されることにより、第１マザー基板１０００と第２マザー基板２０００が接着される。

【００５８】

その後、貼り合わされた第１マザー基板１０００と第２マザー基板２０００を複数の表示パネル１０に切断する。この時、接着剤１５２が形成されているので、切断工程時に発生する応力が切断面に伝えられることを防止することができる。これにより、切断工程時に発生する不良率を低下させることができる。

【００５９】

この後、接着剤１５２の不連続部５２を介してフリット１５１と接着剤１５２との間に補強材１５３を注入する。フリット１５１と接着剤１５２は、所定の間隔だけ離隔されて形成されるため、フリット１５１と接着剤１５２の間には空き空間が形成される。この空き空間により、第１マザー基板１０００と第２マザー基板２０００は完全に貼り合わされず、そのため、衝撃に弱くなる恐れがある。すなわち、基板を単位基板に切断する工程を行う際に素子にクラックが発生するなどの損傷が起こり易くなる。したがって、補強材１５３はフリット１５１と接着剤１５２との間に存在する空き空間が埋められるように形成して、所定の工程が行われる際に加えられる衝撃を吸収するようにする。一方、補強材１５３は接着剤１５２よりも粘度の低い物質を使用しなければならず、エポキシ、アクリル及びウレタン系で構成される群から選択された少なくとも１つの材料で形成されることが好ましい。この時、補強材１５３が接着剤１５２よりも粘度が高いか、または同一である場合に補強材１５３が流動し難くなるため、不連続部５２を介して補強材１５３を注入するのに困難が生じる。これに適した補強材１５３の好ましい粘度は、１００ｃｐ～４０００ｃｐの範囲である。また、補強材１５３を注入する工程は、毛細管現象を利用するか、圧力差を利用して行える。（図５ｅ）

【００６０】

この後、補強材１５３を硬化する。この時、補強材１５３を硬化する工程は、紫外線または熱または急速硬化を用いて行える。（図５ｆ）

【００６１】

なお、上記実施形態は本発明の理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明は、その趣旨を逸脱することなく、変更、改良され得ると共に、本発明はその等価物も含まれる。

【図面の簡単な説明】

【００６２】

【図１】本発明に係る有機電界発光表示装置の一例を示す平面概念図である。

【図２】本発明に係る有機電界発光表示装置に採用された封止基板の一例を示す平面図である。

【図３】本発明に係る有機電界発光表示装置の一例を示す断面図である。

【図４】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法の第１の実施形態を示す順序図である。

【図５ａ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法の第２の実施形態を示す順序図である。

【図５ｂ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法の第２の実施形態を示す順序図である。

【図５ｃ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法の第２の実施形態を示す順序図である。

【図５ｄ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法の第２の実施形態を示す順序図である。

【図５ｅ】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法の第２の実施形態を示す順序図である。

10

20

30

40

50

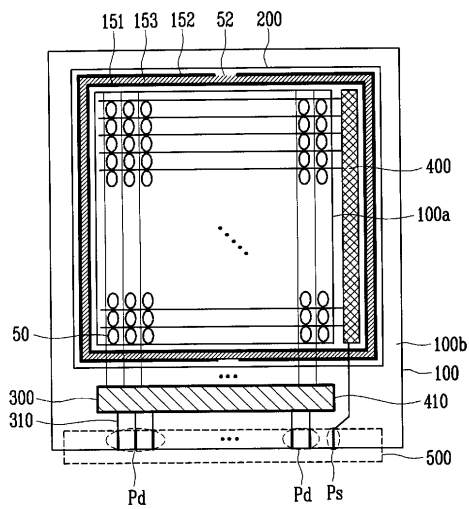
【図 5 f】本発明に係る有機電界発光表示装置の製造方法の第 2 の実施形態を示す順序図である。

【符号の説明】

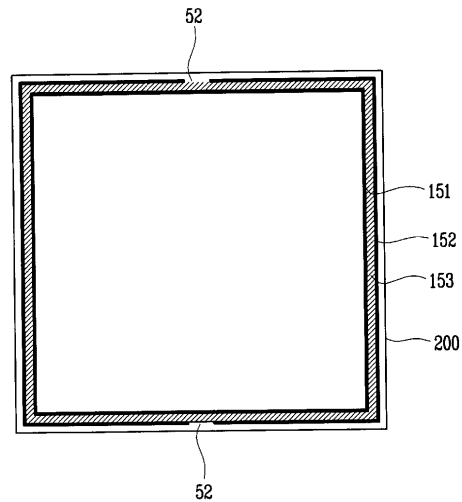
【 0 0 6 3 】

1 5 1	フリット
1 5 3	補強材
1 5 2	接着剤
5 2	不連続部

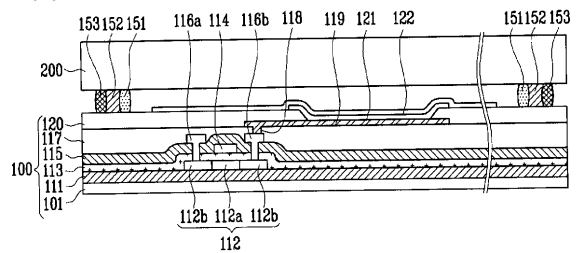
【 図 1 】



【 図 2 】



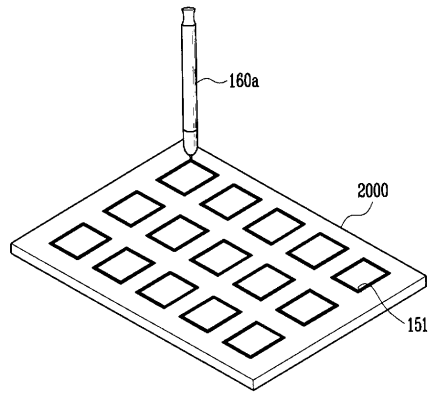
【 図 3 】



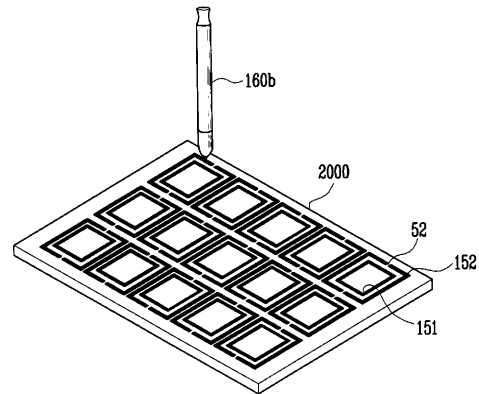
【図 4】



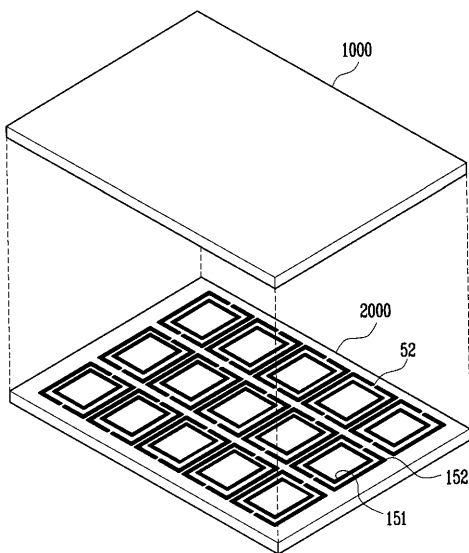
【図 5 a】



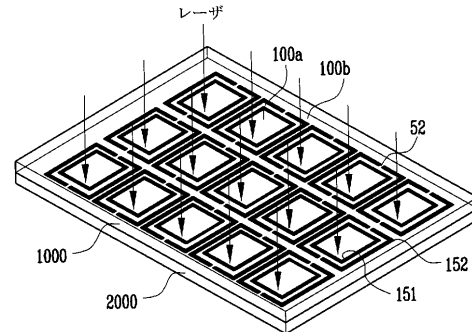
【図 5 b】



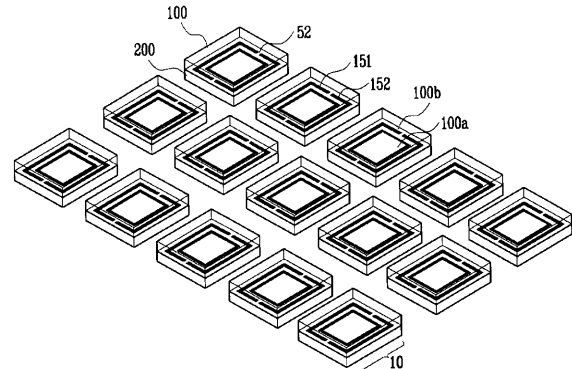
【図 5 c】



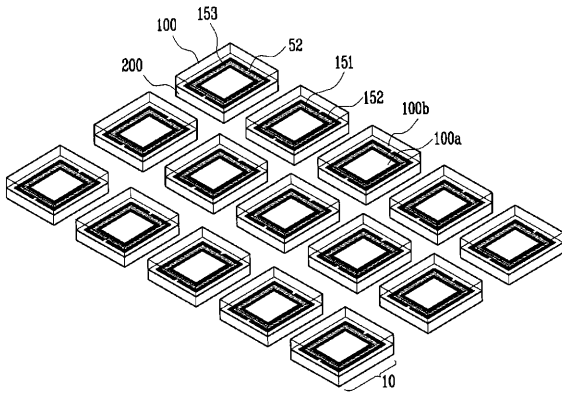
【図 5 d】



【図 5 e】



【図 5 f】



フロントページの続き

(72)発明者 金 兌承

大韓民国京畿道龍仁市器興邑貢税里 4 2 8 - 5 三星エスディアイ中央研究所内

(72)発明者 林 大鎬

大韓民国京畿道龍仁市器興邑貢税里 4 2 8 - 5 三星エスディアイ中央研究所内

(72)発明者 李 浩碩

大韓民国京畿道龍仁市器興邑貢税里 4 2 8 - 5 三星エスディアイ中央研究所内

F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC45 EE03 EE42 EE49 EE55 FF03 FF17 GG07

GG26 GG28 GG37 GG52

5C094 AA31 AA38 AA42 AA43 BA03 BA27 CA19 DA07

专利名称(译)	有机电致发光显示装置及其制造方法		
公开(公告)号	JP2007200842A	公开(公告)日	2007-08-09
申请号	JP2006178508	申请日	2006-06-28
[标]申请(专利权)人(译)	三星斯笛爱股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星エスディアイ株式会社		
[标]发明人	李鐘禹 金兌承 林大鎬 李浩碩		
发明人	李 鐘禹 金 兌承 林 大鎬 李 浩碩		
IPC分类号	H05B33/04 H05B33/10 H01L51/50 G09F9/30 H01L27/32		
CPC分类号	H01L27/3244 H01L51/5246 H01L2251/566 Y10T428/10		
FI分类号	H05B33/04 H05B33/10 H05B33/14.A G09F9/30.309 G09F9/30.365.Z G09F9/30.365 H01L27/32		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC45 3K107/EE03 3K107/EE42 3K107/EE49 3K107/EE55 3K107/FF03 3K107/FF17 3K107/GG07 3K107/GG26 3K107/GG28 3K107/GG37 3K107/GG52 5C094/AA31 5C094/AA38 5C094/AA42 5C094/AA43 5C094/BA03 5C094/BA27 5C094/CA19 5C094/DA07		
代理人(译)	渡边 隆 村山彦		
优先权	1020060007353 2006-01-24 KR 1020060025755 2006-03-21 KR		
其他公开文献	JP4456092B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种有机电致发光显示装置，除了密封材料之外还具有粘合剂和增强材料，并且具有高抗冲击性；并提供其制造方法。该解决方案：该有机电致发光显示装置包括：第一基板，包括像素区域，在该像素区域中，形成由第一电极，有机层和第二电极构成的至少一个有机发光元件，以及形成在外部的非像素区域像素区域的外围；第二基板，附接到包括像素区域的第一基板的一个区域；所述玻璃料设置在所述第一基板的非像素区域与所述第二基板之间，用于将所述第一基板和所述第二基板彼此连接；粘合剂，沿着玻璃料的周边区域隔开，并包括至少两个不连续部分；加强构件设置在玻璃料和粘合剂之间。Z

